香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED

华虹宏力半导体有限公司

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：01347）

新闻稿

二零二六年第三季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。
本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2026 年 11 月 5 日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹宏力半导体有限公司（香港联交所股票代号：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二六年九月三十日止三个月的综合经营业绩。

二零二六年第三季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入达 9.871 亿美元，同比增长 19.9%，环比增长 9.9%。不含华力微[1]合并的销售收入 8.034 亿美元，超过季度指引 7.7 亿美元至 7.8 亿美元之间。
- 毛利率 24.6%，同比上升 7.6 个百分点，环比上升 4.7 个百分点。不含华力微合并的毛利率 19.9%，超过季度指引 16%至 18%之间。
- 母公司拥有人应占利润 1.234 亿美元，同比上升 147.1%，环比上升 77.7%。

二零二六年第四季度指引

- 我们预计销售收入约在 10.8 亿美元至 10.9 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 25%至 26%之间。

[1] *上海华力微电子有限公司，以下简称“华力微”。*

总裁致辞

华虹宏力董事会主席兼总裁白鹏博士对公司二零二六年第三季度业绩评论道：

“二零二六年第三季度，公司完成对华力微的收购，历时一年的努力圆满收官。据此，除另有说明外，公司所有财务报告现均包含华力微。

过去一个季度，华虹宏力实现销售收入 9.871 亿美元，按重述后可比口径同比增长 19.9%（剔除华力微后，销售收入为 8.034 亿美元，高于上季度指引 7.7 亿至 7.8 亿美元的区间上限）。毛利率为 24.6%，同比上升 7.6 个百分点（剔除华力微后，毛利率为 19.9%，高于上季度指引 16%至 18%的区间上限）。本季度母公司拥有人应占利润达 1.234 亿美元。销售收入大幅增长，再创历史新高，关键财务指标同比及环比均显著提升。本季度，公司晶圆厂保持高产能利用率，出货量与平均销售价格均稳步上行，并继续按计划推进产能扩张项目。华力微整合已证明能带来财务增益及运营协同。目前，十二英寸业务的收入占比已达 70.7%。”

白总继续表示：“人工智能相关产品持续拉动全球半导体市场需求。工业及汽车市场正逐步改善。作为拥有广泛技术组合的特色工艺晶圆代工企业，华虹宏力的微控制器、闪存、电源管理及功率器件等产品需求日益增长，即使公司持续扩充产能，部分细分领域的供应仍相应趋紧。我们预计量价齐升的态势将持续一段时间。公司将继续全力聚焦卓越运营，为股东创造价值。”

电话会议公告

日期:	2026 年 11 月 5 日，星期四
时间:	17:00 香港/上海时间 04:00 美国东部时间
发言人:	白鹏，董事会主席兼总裁 王鼎，执行副总裁兼首席财务官
网上会议:	会议将在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或 https://edge.media-server.com/mmc/p/amy9mj7q 作在线直播 （请提前注册登记） 如您不接入互联网，也可以通过电话参与会议:
电话会议:	请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN（个人身份识别码）。 https://register-conf.media-server.com/register/BI164ceba3f66d4e49b6565d87d913aff0 ***重要提示***: 在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN（个人身份识别码）才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN（个人身份识别码）。
网上重播:	直播约 2 小时后，您可于 12 个月内在以下网页重复收听会议。 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

关于华虹宏力半导体

华虹宏力半导体有限公司（“华虹宏力”，A 股代码：688347，港股代码：01347）（“本公司”）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先进“特色 IC + 功率器件”的发展战略，为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频和功率器件等特色工艺技术的持续创新，有力支持人工智能及数据中心、新能源汽车、工业智造、绿色能源、物联网等新兴领域应用，其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是中国先进芯片制造主流工艺技术拥有者华虹集团的一员。

本公司在上海金桥和张江拥有三座 8 英寸晶圆厂和一座 12 英寸晶圆厂。另在江苏省无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂。目前，本公司正在推进无锡三期 12 英寸生产线的建设。

如欲取得更多公司相关资料，请浏览：www.huahonggrace.com。

经营业绩概要

（以千美元计，每股盈利和营运数据除外）

	二零二六年第三季度（未经审核并不含华力微）[2]	二零二六年第三季度（未经审核）	二零二五年第三季度（未经审核并经重列）[3]	二零二六年第二季度（未经审核并经重列）[3]	同比	环比
销售收入	803,401	987,133	823,078	898,483	19.9 %	9.9 %
毛利	159,964	242,643	140,313	179,227	72.9 %	35.4 %
毛利率	*19.9 %*	*24.6 %*	*17.0 %*	*19.9 %*	*7.6*	*4.7*
经营开支	(94,520)	(100,533)	(117,350)	(116,408)	(14.3)%	(13.6)%
其他(损失)/收入净额	(2,609)	(8,666)	16,285	(4,699)	(153.2)%	84.4 %
税前溢利	62,835	133,444	39,248	58,120	240.0 %	129.6 %
所得税开支	(13,391)	(13,391)	(10,259)	(7,632)	30.5 %	75.5 %
期内溢利	49,444	120,053	28,989	50,488	314.1 %	137.8 %
净利润率	*6.2 %*	*12.2 %*	*3.5 %*	*5.6 %*	*8.7*	*6.6*
以下各方应占：						
母公司拥有人	68,831	123,435	49,950	69,480	147.1 %	77.7 %
非控股权益	(19,387)	(3,382)	(20,961)	(18,992)	(83.9)%	(82.2)%
持有人应占每股盈利						
基本	0.040	0.066	0.027	0.037	144.4 %	78.4 %
摊薄	0.040	0.066	0.027	0.037	144.4 %	78.4 %
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,618	1,911	1,714	1,837	11.5 %	4.0 %
产能利用率[4]	*101.0 %*	*102.9 %*	*108.7 %*	*104.1 %*	*(5.8)*	*(1.2)*
净资产收益率[5]	*4.0 %*	*6.8 %*	*3.2 %*	*4.0 %*	*3.6*	*2.8*

二零二六年第三季度

- *销售收入*达 9.871 亿美元，同比增长 19.9%，环比增长 9.9%，主要得益于付运晶圆数量上升及平均销售价格上涨。
- *毛利率* 24.6%，同比上升 7.6 个百分点，环比上升 4.7 个百分点，主要得益于平均销售价格上涨，部分被折旧成本上升所抵消。
- *经营开支* 1.005 亿美元，同比下降 14.3%，主要由于折旧费及研发工程片开支下降，环比下降 13.6%，主要由于员工开支及研发工程片开支下降。
- *其他损失净额*870 万美元，相比上年同期其他收入净额 1,630 万美元，主要由于财务费用上升；环比上升 84.4%，主要由于本季度分占联营公司损失 620 万美元。
- *所得税开支*1,340 万美元，同比上升 30.5%，环比上升 75.5%。
- *期内溢利*1.201 亿美元，同比上升 314.1%，环比上升 137.8%。
- *母公司拥有人应占利润*1.234 亿美元，同比上升 147.1%，环比上升 77.7%。
- *基本每股盈利* 0.066 美元，同比上升 144.4%，环比上升 78.4%。
- *净资产收益率（年化）* 6.8%，同比上升 3.6 个百分点，环比上升 2.8 个百分点。

[2] *本列展示剔除收购华力微股权影响的经营业绩。*

[3] *本季度公司完成合并华力微，对二零二六年第二季度和二零二五年第三季度的经营业绩进行了重列。*

[4] *产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。*

[5] *母公司拥有人应占利润/加权平均母公司拥有人应占净资产。*

销售收入分析

按类别划分的销售收入	二零二六年第三季度千美元(未经审核)	二零二六年第三季度%(未经审核)	二零二五年第三季度千美元(未经审核并经重列)	二零二五年第三季度%(未经审核并经重列)	同比千美元	同比%
晶圆	960,615	97.3 %	794,927	96.6 %	165,688	20.8 %
其他	26,518	2.7 %	28,151	3.4 %	(1,633)	(5.8)%
销售收入总额	987,133	100.0 %	823,078	100.0 %	164,055	19.9 %

- 本季度 97.3%的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的销售收入	二零二六年第三季度千美元(未经审核)	二零二六年第三季度%(未经审核)	二零二五年第三季度千美元(未经审核并经重列)	二零二五年第三季度%(未经审核并经重列)	同比千美元	同比%
8 吋晶圆	289,227	29.3 %	258,805	31.4 %	30,422	11.8 %
12 吋晶圆	697,906	70.7 %	564,273	68.6 %	133,633	23.7 %
销售收入总额	987,133	100.0 %	823,078	100.0 %	164,055	19.9 %

- 本季度*来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入*分别为 2.892 亿美元及 6.979 亿美元。

销售收入分析

按地域划分的销售收入	二零二六年第三季度千美元（未经审核）	二零二六年第三季度%（未经审核）	二零二五年第三季度千美元（未经审核并经重列）	二零二五年第三季度%（未经审核并经重列）	同比千美元	同比%
中国[6]	760,779	77.1 %	664,056	80.7 %	96,723	14.6 %
北美[7]	111,850	11.3 %	63,889	7.8 %	47,961	75.1 %
亚洲其他[8]	76,863	7.8 %	76,708	9.3 %	155	0.2 %
欧洲	37,641	3.8 %	18,425	2.2 %	19,216	104.3 %
销售收入总额	987,133	100.0 %	823,078	100.0 %	164,055	19.9 %

- *本季度来自于中国的销售收入* 7.608 亿美元，占销售收入总额的 77.1%，同比增长 14.6%，主要得益于 MCU、闪存、智能卡芯片、逻辑及通用 MOSFET 的需求增加，部分被模拟产品的需求下降所抵消。
- *本季度来自于北美的销售收入* 1.119 亿美元，同比增长 75.1%，主要得益于电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- *本季度来自于亚洲其他地区的销售收入* 7,690 万美元，同比持平。
- *本季度来自于欧洲的销售收入* 3,760 万美元，同比增长 104.3%，主要得益于 MCU 产品的需求增加。

[6] *包括中国大陆及中国香港。*

[7] *包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。*

[8] *包括中国台湾及日本。*

销售收入分析

按技术平台划分的销售收入	二零二六年第三季度千美元（未经审核）	二零二六年第三季度%（未经审核）	二零二五年第三季度千美元（未经审核并经重列）	二零二五年第三季度%（未经审核并经重列）	同比千美元	同比%
嵌入式非易失性存储器	252,467	25.5 %	177,143	21.5 %	75,324	42.5 %
独立式非易失性存储器	147,599	15.0 %	115,113	14.0 %	32,486	28.2 %
功率器件	202,024	20.5 %	169,036	20.5 %	32,988	19.5 %
逻辑及射频	185,160	18.8 %	185,703	22.6 %	(543)	(0.3)%
模拟与电源管理	199,883	20.2 %	176,083	21.4 %	23,800	13.5 %
销售收入总额	987,133	100.0 %	823,078	100.0 %	164,055	19.9 %

- *本季度嵌入式非易失性存储器销售收入* 2.525 亿美元，同比增长 42.5%，主要得益于 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- *本季度独立式非易失性存储器销售收入* 1.476 亿美元，同比增长 28.2%，主要得益于闪存产品的需求增加。
- *本季度功率器件销售收入* 2.020 亿美元，同比增长 19.5%，主要得益于通用 MOSFET 产品需求增加。
- *本季度逻辑及射频销售收入* 1.852 亿美元，同比持平。
- *本季度模拟与电源管理销售收入* 1.999 亿美元，同比增长 13.5%，主要得益于电源管理产品的需求增加。

销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二六年第三季度千美元（未经审核）	二零二六年第三季度%（未经审核）	二零二五年第三季度千美元（未经审核并经重列）	二零二五年第三季度%（未经审核并经重列）	同比千美元	同比%
65nm 及以下	437,849	44.4 %	360,095	43.8 %	77,754	21.6 %
90nm 及 95nm	173,842	17.6 %	144,396	17.5 %	29,446	20.4 %
0.11μm 及 0.13μm	85,145	8.6 %	73,231	8.9 %	11,914	16.3 %
0.15μm 及 0.18μm	41,523	4.2 %	36,492	4.4 %	5,031	13.8 %
0.25μm	2,745	0.3 %	3,163	0.4 %	(418)	(13.2)%
0.35μm 及以上	246,029	24.9 %	205,701	25.0 %	40,328	19.6 %
销售收入总额	987,133	100.0 %	823,078	100.0 %	164,055	19.9 %

- *本季度 65nm 及以下工艺技术节点的销售收入* 4.378 亿美元，同比增长 21.6%，主要得益于电源管理、闪存及 MCU 产品的需求增加。
- *本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入* 1.738 亿美元，同比增长 20.4%，主要得益于 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- *本季度 0.11μm 及 0.13μm 工艺技术节点的销售收入* 8,510 万美元，同比增长 16.3%，主要得益于 MCU 产品的需求增加。
- *本季度 0.15μm 及 0.18μm 工艺技术节点的销售收入* 4,150 万美元，同比增长 13.8%，主要得益于电源管理产品的需求增加。
- *本季度 0.25μm 工艺技术节点的销售收入* 270 万美元，同比减少 13.2%。
- *本季度 0.35μm 及以上工艺技术节点的销售收入* 2.460 亿美元，同比增长 19.6%，主要得益于通用 MOSFET 产品的需求增加。

销售收入分析

按终端市场分布划分的销售收入	二零二六年第三季度千美元（未经审核）	二零二六年第三季度%（未经审核）	二零二五年第三季度千美元（未经审核并经重列）	二零二五年第三季度%（未经审核并经重列）	同比千美元	同比%
消费电子	688,210	69.7 %	544,384	66.2 %	143,826	26.4 %
工业及汽车	194,525	19.7 %	140,000	17.0 %	54,525	38.9 %
通信	90,443	9.2 %	126,268	15.3 %	(35,825)	(28.4)%
计算	13,955	1.4 %	12,426	1.5 %	1,529	12.3 %
销售收入总额	**987,133**	**100.0 %**	**823,078**	**100.0 %**	**164,055**	**19.9 %**

- *本季度消费电子*作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 6.882 亿美元，占销售收入总额的 69.7%，同比增长 26.4%，主要得益于 MCU、闪存及电源管理产品的需求增加。
- *本季度工业及汽车产品销售收入* 1.945 亿美元，同比增长 38.9%，主要得益于电源管理产品的需求增加。
- *本季度通信类产品销售收入* 9,040 万美元，同比下降 28.4%，主要由于 CIS 产品需求下降。
- *本季度计算类产品销售收入* 1,400 万美元，同比增长 12.3%，主要得益于 MCU 产品的需求增加。

产能[9]及产能利用率

	二零二六年第三季度（未经审核）	二零二五年第三季度（未经审核并经重列）	二零二六年第二季度（未经审核并经重列）
总产能(折合 8 吋千片晶圆)	636	543	593
总体产能利用率	*102.9 %*	*108.7 %*	*104.1 %*

- 本季度末月*产能* 636,000 片 8 吋等值晶圆。*总体产能利用率* 为 102.9%。

付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二六年第三季度（未经审核）	二零二五年第三季度（未经审核并经重列）	二零二六年第二季度（未经审核并经重列）	同比	环比
付运晶圆	1,911	1,714	1,837	11.5 %	4.0 %

- 本季度*付运晶圆*1,911,000 片，同比上升 11.5%，环比上升 4.0%。

[9] *期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。*

经营开支分析

以千美元计	二零二六年第三季度(未经审核)	二零二五年第三季度(未经审核并经重列)	二零二六年第二季度(未经审核并经重列)	同比	环比
销售及分销费用	2,801	2,550	3,021	9.8 %	(7.3)%
管理费用[10]	97,509	118,230	114,617	(17.5)%	(14.9)%
贸易应收款项及应收票据减值损失	223	(3,430)	(1,230)	(106.5)%	(118.1)%
经营开支	100,533	117,350	116,408	(14.3)%	(13.6)%

- *经营开支* 1.005 亿美元，同比下降 14.3%，主要由于折旧费及研发工程片开支下降，环比下降 13.6%，主要由于员工开支及研发工程片开支下降。

其他(损失)/收入净额

以千美元计	二零二六年第三季度(未经审核)	二零二五年第三季度(未经审核并经重列)	二零二六年第二季度(未经审核并经重列)	同比	环比
利息收入	14,741	15,096	15,223	(2.4)%	(3.2)%
汇兑收入/(损失)	542	346	(5,859)	56.6 %	(109.3)%
分占联营公司(损失)/溢利	(6,191)	1,843	9,491	(435.9)%	(165.2)%
财务费用	(29,500)	(18,042)	(31,468)	63.5 %	(6.3)%
政府补贴	11,939	16,199	6,043	(26.3)%	97.6 %
其他	(197)	843	1,871	(123.4)%	(110.5)%
其他(损失)/收入淨額	(8,666)	16,285	(4,699)	(153.2)%	84.4 %

- *其他損失淨額* 870 萬美元，相比上年同期其他收入淨額 1,630 萬美元，主要由於財務費用上升；環比上升 84.4%，主要由於本季度分占聯營公司損失 620 万美元。

[10] *管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。*

现金使用分析

以千美元计	二零二六年第三季度(未经审核)	二零二五年第三季度(未经审核并经重列)	二零二六年第二季度(未经审核并经重列)	同比	环比
经营活动所得现金流量净额	377,277	279,004	419,870	35.2 %	(10.1)%
投资活动所用现金流量净额	(549,993)	(258,140)	(330,367)	113.1 %	66.5 %
融资活动所得/(用)现金流量净额	1,114,615	56,873	(422,727)	1,859.8 %	(363.7)%
外汇汇率变动影响净额	44,138	25,328	65,000	74.3 %	(32.1)%
现金及现金等价物变动影响净额	986,037	103,065	(268,224)	856.7 %	(467.6)%

- *本季度经营活动所得现金流量净额* 3.773 亿美元，同比上升 35.2%，主要由于客户收款上升，环比下降 10.1%，主要由于本期支付人工开支上升。
- *投资活动所用现金流量净额* 5.500 亿美元，其中包括固定资产投资支出 6.010 亿美元，部分被收到利息收入 2,650 万美元，及政府对设备的补贴 2,450 万美元所抵消。
- *融资活动所得现金流量净额* 11.146 亿美元，其中非控股权益资本注资 11.676 亿美元，提取银行借款 7,420 万美元，员工行权发行股份收到 10 万美元，部分被偿还银行借款 9,990 万美元，支付利息 2,640 万美元，及支付租赁负债 100 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计	于九月三十日二零二六年(未经审核)	于六月三十日二零二六年(未经审核并经重列)
资产总额	17,727,129	16,019,042
负债总额	6,407,387	6,062,217
所有者权益总额	11,319,742	9,956,825
资产负债率[11]	*36.1 %*	*37.8 %*

资本开支

以千美元计	二零二六年第三季度(未经审核)	二零二六年第二季度(未经审核并经重列)
华虹 8 吋	29,249	30,683
华虹 12 吋	571,784	332,573
合计	601,033	363,256

- 本季度*资本开支* 6.010 亿美元，其中 5.718 亿美元用于华虹 12 吋，2,920 万美元用于华虹 8 吋。

[11] *资产负债率=负债总额/资产总额。*

流动性分析

以千美元计	于九月三十日 二零二六年 (未经审核)	于六月三十日 二零二六年 (未经审核 并经重列)
已竣工待售物业	224,908	222,405
存货	737,791	711,164
贸易应收款项及应收票据	367,102	388,242
预付款项、其他应收款项及其他资产	747,453	703,329
应收关联方款项	32,788	24,691
已冻结及定期存款	45,937	45,355
现金及现金等价物	6,048,435	5,062,398
流动资产总额	8,204,414	7,157,584
贸易应付款项	284,361	356,588
其他应付款项及暂估费用	1,282,472	905,397
计息银行借款	1,942,232	1,985,982
一年内到期长期应付款	-	7,331
租赁负债	1,758	2,006
政府补助	134,031	119,681
应付关联方款项	3,363	4,310
应付所得税	22,532	14,549
流动负债总额	3,670,749	3,395,844
净营运资金	4,533,665	3,761,740
速动比率	*2.0*	*1.8*
流动比率	*2.2*	*2.1*
贸易应收款项及应收票据周转天数	34	41
存货周转天数	88	87

- *贸易应付款项* 由上季度末的 3.566 亿美元下降至本季度末的 2.844 亿美元，主要由于本期对供货商的付款增加.
- *其他应付款项及暂估费用* 由上季度末的 9.054 亿美元上升至本季度末的 12.825 亿美元，主要由于应付资本支出增加。
- *净营运资金* 本季度末 45.337 亿美元，流动比率 2.2。
- *贸易应收款项及应收票据周转天数* 34 天。
- *存货周转天数* 88 天。

上述公布详情请参阅公司网站 www.huahonggrace.com。

经重列的各季度经营业绩概要

（以千美元计，每股盈利和营运数据除外）

	如先前呈报				经重列			
	二零二五年第三季度（未经审核）	二零二五年第四季度（未经审核）	二零二六年第一季度（未经审核）	二零二六年第二季度（未经审核）	二零二五年第三季度（未经审核）	二零二五年第四季度（未经审核）	二零二六年第一季度（未经审核）	二零二六年第二季度（未经审核）
销售收入	635,180	659,882	660,925	717,537	823,078	840,696	824,473	898,483
毛利	**85,854**	**85,464**	**86,059**	**118,404**	**140,313**	**125,442**	**128,552**	**179,227**
毛利率	***13.5 %***	***13.0 %***	***13.0 %***	***16.5 %***	***17.0 %***	***14.9 %***	***15.6 %***	***19.9 %***
经营开支	(100,433)	(130,165)	(105,613)	(109,083)	(117,350)	(141,506)	(112,574)	(116,408)
其他收入/(损失)净额	17,752	34,110	(2,448)	2,189	16,285	26,900	(5,489)	(4,699)
税前溢利/(损失)	**3,173**	**(10,591)**	**(22,002)**	**11,510**	**39,248**	**10,836**	**10,489**	**58,120**
所得税(开支)/抵免	(10,363)	(8,069)	4,735	(7,632)	(10,259)	(8,008)	4,735	(7,632)
期内(损失)/溢利	**(7,190)**	**(18,660)**	**(17,267)**	**3,878**	**28,989**	**2,828**	**15,224**	**50,488**
净利润率	***(1.1)%***	***(2.8)%***	***(2.6)%***	***0.5 %***	***3.5 %***	***0.3 %***	***1.8 %***	***5.6 %***
以下各方应占：								
母公司拥有人	25,725	17,454	20,929	38,639	49,950	35,359	42,524	69,480
非控股权益	(32,915)	(36,114)	(38,196)	(34,761)	(20,961)	(32,531)	(27,300)	(18,992)
母公司拥有人每股盈利								
基本（美元）	0.015	0.010	0.012	0.022	0.027	0.019	0.023	0.037
摊薄（美元）	0.015	0.010	0.012	0.022	0.027	0.019	0.023	0.037
付运晶圆(折合 8吋千片)	1,400	1,448	1,453	1,538	1,714	1,745	1,736	1,837
产能利用率	109.5%	103.8 %	99.7%	102.8 %	108.7%	104.2 %	101.1%	104.1%
净资产收益率(年化)	1.6%	1.2 %	1.2 %	2.4 %	3.2 %	2.0 %	2.4 %	4.0 %

2026 年 9 月，公司完成了收购华力微股权的交易。该交易按照相关会计准则，应作为同一控制下企业合并进行会计处理，因此比较期间的数据已重列。

华虹宏力半导体有限公司

简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于九月三十日 二零二六年 (未经审核)	**于九月三十日 二零二五年 (未经审核 并经重列)**	**于六月三十日 二零二六年 (未经审核 并经重列)**
销售收入	987,133	823,078	898,483
销售成本	(744,490)	(682,765)	(719,256)
毛利	**242,643**	**140,313**	**179,227**
其他收入及收益	27,044	32,687	23,137
销售及分销费用	(2,801)	(2,550)	(3,021)
管理费用	(97,509)	(118,230)	(114,617)
贸易应收款项及应收票据减值损失	(223)	3,430	1,230
其他费用	(19)	(203)	(5,859)
财务费用	(29,500)	(18,042)	(31,468)
分占联营公司(损失)/溢利	(6,191)	1,843	9,491
税前溢利	**133,444**	**39,248**	**58,120**
所得税开支	(13,391)	(10,259)	(7,632)
期内溢利	**120,053**	**28,989**	**50,488**
以下各方应占:			
母公司拥有人	123,435	49,950	69,480
非控股权益	(3,382)	(20,961)	(18,992)
持有人应占每股盈利			
基本	0.066	0.027	0.037
摊薄	0.066	0.027	0.037
用于计算持有人应占每股基本盈利的期内已发行普通股加权平均数	1,873,036,969	1,855,794,006	1,861,964,246
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的期内已发行普通股加权平均数	1,873,094,983	1,857,346,418	1,862,022,099

华虹宏力半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于九月三十日 二零二六年 (未经审核)	于六月三十日 二零二六年 (未经审核 并经重列)	于九月三十日 二零二五年 (未经审核 并经重列)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	8,166,992	7,520,454	6,415,117
投资物业	54,451	53,845	54,154
使用权资产	58,078	57,906	65,850
无形资产	33,777	37,068	42,629
于联营公司的投资	167,106	183,072	147,349
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	748,292	763,190	368,411
以公允价值计量且变动计入损益的金融资产	8,909	8,809	-
长期预付款项	276,598	228,796	42,432
应收关联方款项	8,512	8,318	8,970
递延所得税资产	-	-	9,119
非流动资产总额	9,522,715	8,861,458	7,154,031
流动资产			
已竣工待售物业	224,908	222,405	223,302
存货	737,791	711,164	718,385
贸易应收款项及应收票据	367,102	388,242	323,867
预付款项、其他应收款项及其他资产	747,453	703,329	494,794
应收关联方款项	32,788	24,691	21,050
已冻结存款及定期存款	45,937	45,355	32,135
现金及现金等价物	6,048,435	5,062,398	4,357,050
流动资产总额	8,204,414	7,157,584	6,170,583
流动负债			
贸易应付款项	284,361	356,588	368,483
其他应付款项及暂估费用	1,282,472	905,397	734,529
计息银行借款	1,942,232	1,985,982	457,803
一年内到期长期应付款	-	7,331	-
租赁负债	1,758	2,006	3,598
政府补助	134,031	119,681	68,790
应付关联方款项	3,363	4,310	21,602
应付所得税	22,532	14,549	14,341
流动负债总额	3,670,749	3,395,844	1,669,146
流动资产净额	4,533,665	3,761,740	4,501,437
总资产减流动负债	14,056,380	12,623,198	11,655,468

	截至		
	于九月三十日 二零二六年 (未经审核)	于六月三十日 二零二六年 (未经审核 并经重列)	于九月三十日 二零二五年 (未经审核 并经重列)
非流动负债			
计息银行借款	2,066,658	1,999,824	2,464,562
租赁负债	7,652	7,938	15,329
递延税项负债	41,819	45,008	7,123
长期应付款	620,509	613,603	-
非流动负债总额	2,736,638	2,666,373	2,487,014
净资产	11,319,742	9,956,825	9,168,454
权益和负债权益			
股本	5,709,809	4,987,827	4,982,556
储备	1,253,134	2,269,969	1,521,497
本公司拥有人应占权益	6,962,943	7,257,796	6,504,053
非控股权益	4,356,799	2,699,029	2,664,401
权益总额	11,319,742	9,956,825	9,168,454

华虹宏力半导体有限公司

简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于九月三十日 二零二六年 (未经审核)	于九月三十日 二零二五年 (未经审核 并经重列)	于六月三十日 二零二六年 (未经审核 并经重列)
经营活动现金流量:			
税前溢利	133,444	39,248	58,120
折旧及摊销	265,839	202,848	244,736
应占联营公司损失/(溢利)	6,191	(1,843)	(9,491)
营运资金的变动及其它	(28,197)	38,751	126,505
经营活动所得现金流量净额	377,277	279,004	419,870
投资活动现金流量:			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(601,033)	(275,347)	(363,256)
投资其他权益工具	-	(14,030)	(7,286)
投资以公允价值计量且变动计入损益的金融资产	-	-	(8,809)
收到政府对设备的补助	24,484	7,000	28,283
其他投资活动所得现金流量	26,556	24,237	20,701
投资活动所用现金流量净额	(549,993)	(258,140)	(330,367)
融资活动现金流量:			
提取银行贷款	74,238	99,923	201,506
发行股份所得收益	110	14,376	106
非控股权益资本注资	1,167,600	-	-
偿还银行贷款	(99,903)	(47,865)	(583,667)
已付利息	(26,452)	(7,572)	(39,689)
支付租赁负债	(978)	(1,989)	(983)
融资活动所(得)/用现金流量净额	1,114,615	56,873	(422,727)
现金及现金等价物(增加)/减少净额	941,899	77,737	(333,224)
期初现金及现金等价物	5,062,398	4,253,985	5,330,622
外汇汇率变动影响净额	44,138	25,328	65,000
期末现金及现金等价物	6,048,435	4,357,050	5,062,398

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

白鹏(主席兼总裁)

非执行董事

叶峻
孙国栋
陈一敏
熊承艳

独立非执行董事

张祖同
王桂壎太平绅士
封松林

承董事会命
华虹宏力半导体有限公司
白鹏
董事会主席兼执行董事

中国 香港
二零二六年十一月五日